

2.0mm Pitch

SERIES

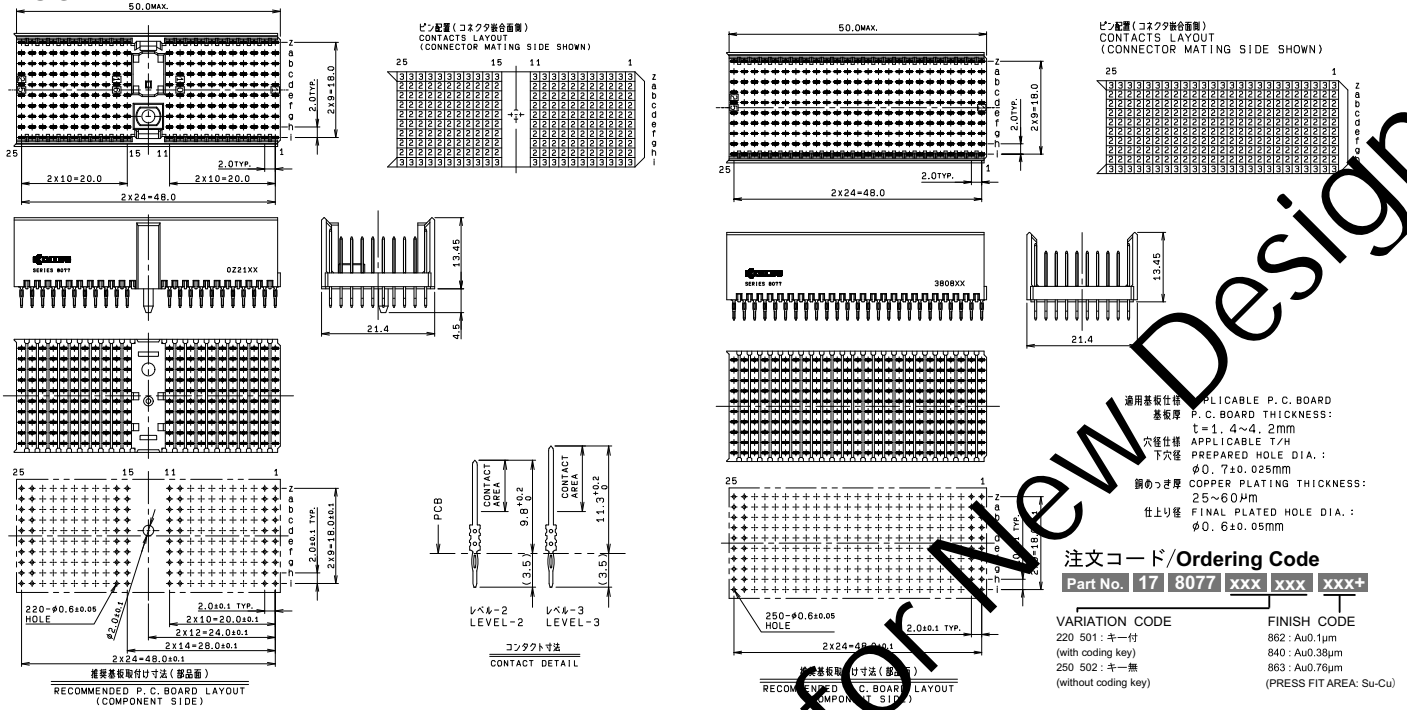
8077

2.0mmハードメトリック マルチラインモジュールコネクタ
2.0mm HM MULTI LINE MODULE CONNECTORS

● PLUG

キー付 (with cording key)

キー無 (without cording key)



● RECEPTACLE

キー付 (with cording key)

キー無 (without cording key)

適用基板仕様 APPLICABLE P.C. BOARD
基板厚 P.C. BOARD THICKNESS:
t = 1.4~4.2mm
穴径仕様 APPLICABLE T/H
下穴径 PREPARED HOLE DIA.:
φ0.7±0.025mm
銅めっき厚 COPPER PLATING THICKNESS:
25~60μm
仕上げ径 FINAL PLATED HOLE DIA.:
φ0.6±0.05mm

注文コード/Ordering Code
Part No. 27 8077 xxx xxx xxx+

VARIATION CODE FINISH CODE
176 011: キー付 (with coding key) 862: Au0.1μm
200 010: キー無 (without coding key) 840: Au0.38μm
863: Au0.76μm
(PRESS FIT AREA: Su-Cu)

生産可能なバリエーションや極数については、営業部にご確認願います。
Feel free to contact our sales department for available variation or number of positions.

